

HC1 温度控制台和 Heat Lid 温控热盖 快速操作指南

一、使用说明

1. 取出仪器，将温控模组置于工作站上，若搭配适配器使用，将适配器水平放置于温度控制台上并用螺丝（3×M2）紧固；
2. 分别将 HC1 温控模组和 Heat Lid 温控模组连接控制模组，HC1 温控模组与控制模组通过 DB9 插头连接，Heat Lid 温控模组与控制模组通过 M12 航空插头连接。M12 航空插头通过缺口对齐插入，插入后将螺帽拧紧；



图 1. HC1 温控模组 DB9 插头



图 2. Heat Lid 温控模组 M12 航空插头

3. 若需连接外控设备，先将串口通讯线的 3pin 接头插入控制模组的接口，将 USB 端插入上位机；

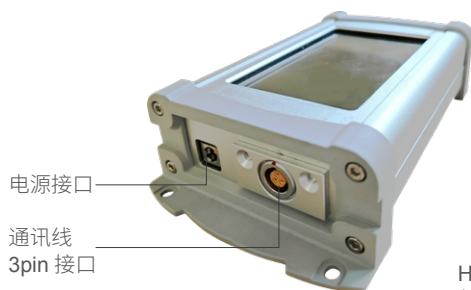


图 3. 控制模组

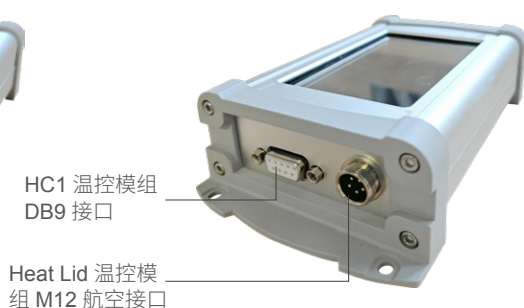


图 4. 控制模组

4. 接通电源，屏幕亮起，显示系统初始化界面后，自动跳转程序设置界面；
5. 点击“设定温度”，弹出温度编辑界面，温度设置范围为实时温度 +5-110°C，输入完成后点击“Enter”，点击“当前状态”编辑框，当前状态由“关闭”变为“开启”，温控模组按照设定温度进行升温，“实时温度”显示升温过程中的实时温度值；

注意：如设定温度低于实时温度，温控模块不开启控温，设备保持当前温度

6. 点击“当前状态”编辑框，当前状态由“开启”变为“关闭”，温控模组停止控温；
7. 电源线插头从插座拔出，设备关闭。

二、通讯连接

为测试通讯连接和方便用户整合设备，莫纳生物提供上位机测试软件、通讯协议和属性定义
以下是上位机软件操作流程：

- 1. 打开莫纳设备合集；
- 2. 点击左侧栏“通信”，选择串口，点击“添加”；
- 3. 点击串口名后的“刷新”，下拉选择相对应的 COM 口；
- 4. 下拉选择波特率，默认为波特率 19200 Baud；
- 5. 点击左侧栏“设备”；
- 6. 选择设备类型：HC1，点击“新增设备名”，编辑设备名后，点击“添加设备”；
- 7. 点击选择通信后的“刷新”，下拉选择对应的 COM 口：波特率；
- 8. 设置底板 / 热盖温度和底板 / 热盖温控时间，底板 / 热盖按照预设时间和温度运行；

底板 / 热盖温度设置范围：室温 +5-110°C

底板 / 热盖温控时间设置范围：99h59min59s，也可以不设置温控时间，通过点击开始 / 停止温控控制设备运行。

点击“刷新”可更新当前温度，点击“实时刷新”可实时更新当前温度。



图 5. 上位机测试软件通信界面



图 6. 上位机测试软件设备界面

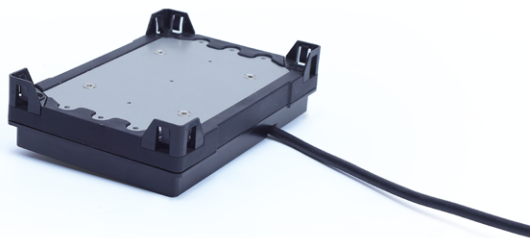


图 7. HC1 温控模组

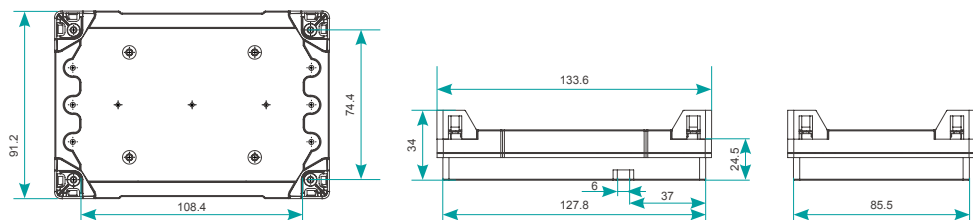


图 8. HC1 温控模组尺寸图

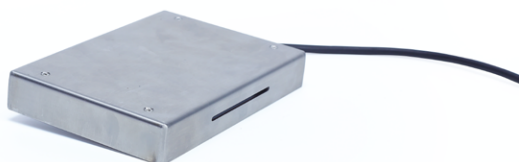


图 9. Heat Lid 温控模组

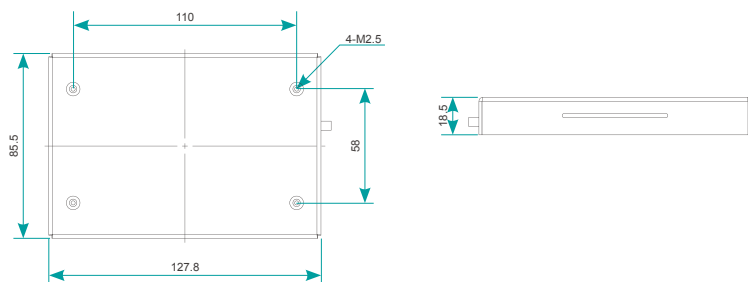


图 10. Heat Lid 温控模组尺寸图

生产商
Producer

莫纳 (苏州) 生物科技有限公司
Monad (Suzhou) Biotech Co., Ltd.

研发生产基地
R&D and Production Bases

苏州：苏州工业园区
杏林街 78 号 13A 栋

E-mail
Web

support@monadbiotech.com
www.monadbiotech.com



400-928-3698



Simply Discover More

至简致真·探索无限